



鉛フリー対応リフローはんだ付け装置 RF-630

RF-630は赤外線式、鉛フリーはんだ対応の小型リフローはんだ付け装置です。卓上の小型リフロー装置ながら遠赤 (IR) 6ゾーン方式で、鉛フリーはんだのリフローはんだ付けに要求される、精密で安定した温度プロファイルを得られます。また、各種鉛フリーはんだの要求に十分対応する、Max350°Cの加熱温度と高精度の温度制御を実現しました。

特長

- 卓上型遠赤外線式 (IR) リフローはんだ付け装置です。300×300mmの基板まで対応します。
- 遠赤 (IR) 6ゾーン、クオーツヒーターによる素早い加熱で、ご希望の温度プロファイルが得られます。
- PID高精度温調器により、Max350°Cまで精密 (±0.3%) な温度制御で、安定した温度プロファイルが得られます。

仕様

- ・加熱部 : 6ゾーン 幅300mm×長さ780mm 入口高さ30mm
ヒーター : 石英管ヒーター IR (波長: 2~10 μm)。
上部: 各ゾーン 0.6kW
下部: 1, 2, 5, 6ゾーン 0.6kW / 3, 4ゾーン 0.3kW
- 加熱方式: 遠赤外線 (IR)
- 温度制御: Max350°C±0.3% P.I.D.温度調節器。
各ゾーン共上部炉内雰囲気温度制御
- ・コンベア : 幅300mm SUSメッシュベルト。90~1400mm/min。
コンベア方向: R→L 又は L→R (指定)。
デジタル式スピード調節器。
- ・冷却 : 出口側 FANによる強制空冷。
- ・電源 : 1φ, 200V/220V 約6.7kW, (220V 約7.8kW)。50/60Hz。
- ・安全装置 : 漏電/過電流ブレーカー。非常停止スイッチ。
警報出力 (過温/低温/ヒーター断線)
- ・外形寸法・重量: (W) 1500×(D) 590×(H) 640mm。約140kg

適合基板

寸法: 15×15mm~300×300mm
板厚: 0.125~2mm
高さ: Max30mm

用途

- ・H-ICやSMT基板のリフローはんだ付け。
- ・鉛フリーはんだのリフローはんだ付け。
- ・熱硬化接着剤の乾燥。その他加熱作業。

オプション

- ・フィンガー・チェーン・コンベア。
- ・外部コンピューター制御。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。